

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）、28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目。
- 本次节余金额为 13,304.90 万元（截至 2026 年 1 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额为准），为提高募集资金的使用效率，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况

详见 2023 年 5 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金总额	996,046.10 万元
募集资金净额	972,351.65 万元
募集资金到账时间	2023 年 4 月 26 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

截至 2026 年 1 月 31 日，本次结项的募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

结项名称	结项时间	调整后的募集资金拟投资总额 ^{注1} (A)	累计已投入募集资金金额(B)	利息收入及理财收益扣除手续费后净额(C)	节余募集资金金额 ^{注2} (D=A-B+C)
后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	2025 年 12 月	60,000.00	47,553.53	612.61	13,059.09
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	2025 年 12 月	280,000.00	285,619.16	5,621.47	2.31
节余募集资金合计金额 ^{注3}		13,304.90 万元			
节余募集资金使用用途及相应金额 ^{注3}		补流，13,304.90 万元			

注：1.2024 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入的募集资金变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”。上表中募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”调整后的募集资金拟投资总额未包括转出的募集资金专户扣除银行手续费后的利息收入及理财收益。

2.“节余募集资金金额”包含本项目尚未支付的合同尾款、设备款等款项，该部分款项后续公司将通过自有资金支付。“节余募集资金金额”未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。

3. 截至 2026 年 1 月 31 日，募集资金专户余额 13,304.90 万元与上述两个募投项目的节余募集资金金额 13,061.40 万元之差 243.50 万元为用自有资金支付且未置换的发行费用及其产生的利息。本次“节余募集资金合计金额”为 13,304.90 万元（截至 2026 年 1 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

4. 上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

三、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本。

2、在“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含 90 纳米及 55 纳米)”实施过程中，公司积极响应国家供应链自主可控战略，系统性地导入性能可靠的国产化硬件解决方案，在保障工艺平台研发进度与技术要求的同时，一定程度地降低了募投项目中硬件的采购成本。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

4、本次募投项目结项后，尚有部分合同尾款、设备款等款项待支付。因上述款项的支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续将通过自有资金支付上述款项。

四、节余募集资金的使用计划

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，本次募投项目结项后，公司拟将节余资金 13,304.90 万元（截至 2026 年 1 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行、中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行、中国银行股份有限公司合肥庐阳支行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实施情况和公司自身经

营情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

六、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）审计委员会审议情况

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。审计委员会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”结项，并将节余募集资金 13,304.90 万元（截至 2026 年 1 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第三十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》

的规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年2月7日